



2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年7月28日

上場会社名 株式会社トーメンデバイス 上場取引所 東
 コード番号 2737 URL <https://www.tomendevices.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 妻木 一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 原 英記 TEL 03-3536-9150
 四半期報告書提出予定日 2022年8月8日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第1四半期	110,945	12.9	3,776	20.0	2,231	△23.0	1,658	△21.6
2022年3月期第1四半期	98,271	46.4	3,145	192.0	2,896	173.5	2,115	165.6

(注) 包括利益 2023年3月期第1四半期 2,585百万円 (10.0%) 2022年3月期第1四半期 2,350百万円 (173.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第1四半期	243.90	—
2022年3月期第1四半期	311.06	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年3月期第1四半期	185,238	39,909	21.1	5,734.17
2022年3月期	116,990	39,364	33.0	5,673.96

(参考) 自己資本 2023年3月期第1四半期 38,998百万円 2022年3月期 38,589百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	—	0.00	—	300.00	300.00
2023年3月期	—	—	—	—	—
2023年3月期（予想）	—	0.00	—	300.00	300.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	440,000	△4.9	7,700	△27.6	7,000	△17.4	5,500	△13.8	808.69

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(注) 詳細は、添付資料6ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご参照下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2023年3月期1Q	6,802,000株	2022年3月期	6,802,000株
② 期末自己株式数	2023年3月期1Q	963株	2022年3月期	935株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2023年3月期1Q	6,801,058株	2022年3月期1Q	6,801,226株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	4
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	6
3. 補足情報	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、円安の進行・資源価格の上昇に伴う原材料コストの増加に加え、中国の都市封鎖を受けたサプライチェーンの停滞などが景況感の下押しに作用し、世界経済においても、新型コロナウイルス対策による活動制限を緩和する動きがみられたものの、中国でのゼロコロナ政策やウクライナ情勢などもあり、前期に引き続き先行き不透明感が継続しました。

エレクトロニクス業界におきましては、テレビ、スマートフォン、PC等の消費者向け巣ごもり需要に一服感があり、5Gインフラおよびデータセンター向けについても、先行き不透明感から投資ペースは緩やかに留まっておりません。

このような状況下、当社グループは、スマートフォン向けメモリー製品および高精細カメラ用CIS（CMOSイメージセンサー）、PC向けDRAM等の売上が減少したものの、データセンターストレージ向けNAND FLASH製品やSiP（システム・イン・パッケージ）ビジネスの売上が拡大し、円安基調もあり、売上高は1,109億45百万円（前年同期比12.9%増）となりました。また、価格下落環境のなか一定の利益を確保したことにより、営業利益は37億76百万円（同20.0%増）、経常利益は22億31百万円（同23.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は16億58百万円（同21.6%減）となりました。

なお、品目別の実績については、7ページの「3. 補足情報（品目別販売実績）」をご参照ください。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の総資産の残高は1,852億38百万円（前連結会計年度末比58.3%増）となりました。これは主に受取手形及び売掛金、商品が増加したことによるものです。

負債の残高は1,453億29百万円（同87.2%増）となりました。これは主に買掛金、短期借入金、前受金及び未払金が増加したことによるものです。

純資産の残高は399億9百万円（同1.4%増）となりました。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上、配当金の支払、為替換算調整勘定の増加によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年4月26日に発表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,713	9,159
受取手形及び売掛金	58,507	78,184
電子記録債権	7,093	3,847
商品	40,163	86,970
前渡金	208	718
預け金	1,503	1,503
その他	808	2,409
流動資産合計	114,998	182,794
固定資産		
有形固定資産	399	423
無形固定資産	82	77
投資その他の資産	1,509	1,943
固定資産合計	1,991	2,444
資産合計	116,990	185,238
負債の部		
流動負債		
買掛金	47,884	66,842
短期借入金	9,500	47,234
未払法人税等	1,249	939
前受金	425	3,645
賞与引当金	330	66
未払金	14,981	22,206
その他	2,722	3,853
流動負債合計	77,094	144,787
固定負債		
退職給付に係る負債	490	501
繰延税金負債	0	0
その他	40	40
固定負債合計	531	542
負債合計	77,625	145,329
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,054	2,054
利益剰余金	34,786	34,405
自己株式	△2	△2
株主資本合計	36,838	36,456
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	177	197
繰延ヘッジ損益	△237	△1,196
為替換算調整勘定	1,810	3,541
その他の包括利益累計額合計	1,750	2,541
非支配株主持分	775	910
純資産合計	39,364	39,909
負債純資産合計	116,990	185,238

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
売上高	98,271	110,945
売上原価	94,339	106,395
売上総利益	3,932	4,549
販売費及び一般管理費	787	773
営業利益	3,145	3,776
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	9	9
持分法による投資利益	6	5
その他	24	5
営業外収益合計	41	21
営業外費用		
支払利息	15	75
債権売却損	85	90
為替差損	182	1,389
その他	7	10
営業外費用合計	290	1,565
経常利益	2,896	2,231
税金等調整前四半期純利益	2,896	2,231
法人税等	733	528
四半期純利益	2,163	1,703
非支配株主に帰属する四半期純利益	47	44
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,115	1,658

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
四半期純利益	2,163	1,703
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	84	19
繰延ヘッジ損益	91	△959
為替換算調整勘定	11	1,822
その他の包括利益合計	187	882
四半期包括利益	2,350	2,585
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,302	2,449
非支配株主に係る四半期包括利益	47	135

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

3. 補足情報

(品目別販売実績)

品目別	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)		増減率 (%)	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
メモリー	71,062	72.3	87,344	78.7	22.9	338,953	73.2
システムLSI	20,528	20.9	18,402	16.6	△10.4	97,323	21.0
半導体小計	91,590	93.2	105,746	95.3	15.5	436,276	94.2
ディスプレイ	3,371	3.4	2,591	2.3	△23.1	14,673	3.2
その他	3,310	3.4	2,608	2.4	△21.2	11,873	2.6
合計	98,271	100.0	110,945	100.0	12.9	462,822	100.0

(メモリー)

スマートフォン向けMCPおよびPC向けDRAM等の売上が減少したものの、データセンターストレージ向けNAND FLASH製品の売上が拡大したことから、この分野の売上高は873億44百万円（前年同期比22.9%増）となりました。

(システムLSI)

国内市場において、SiPビジネスの売上が拡大したものの、中国市場において、スマートフォン向け高画素CISの売上が減少したことから、この分野の売上高は184億2百万円（同10.4%減）となりました。

(ディスプレイ)

テレビ・モニター向け液晶パネルおよびスマートフォン向けOLEDともに売上が減少したことから、この分野の売上高は25億91百万円（同23.1%減）となりました。

(その他)

海外市場向けに、テレビ向けバックライト用LEDの売上が伸びたものの、国内市場において、工作機等向けのバッテリー等の売上が減少したことから、この分野の売上高は26億8百万円（同21.2%減）となりました。

(ご参考)

「メモリー」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

DRAM、NAND FLASH、MCP（マルチチップ・パッケージ）、SSD（ソリッドステートドライブ）等

「システムLSI」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

SoC（システム・オン・チップ）、DDI（ディスプレイドライバーIC）、CIS（CMOSイメージセンサー）、PMIC（パワーマネージメントIC）、SiP（システム・イン・パッケージ）等

「ディスプレイ」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LCD（液晶パネル）、有機EL等

「その他」に含まれる主な商品は以下のとおりです。

LED、MLCC（積層セラミックコンデンサ）、バッテリー、設備等